

DIN-Rail CPU 61

Eigenschaften:

- i.MX536 SODIMM Prozessormodul
 - Freescale i.MX536 Cortex-A8 CPU
 - 800MHz CPU Clock
 - 512 MByte DDR3-RAM
 - 8 MByte NOR-Flash
 - 4 GByte NAND-Flash
- 1x 10/100 Base-T-Ethernet-Port
- 1x DVI Schnittstelle
- 1x RS485 über BUS-Connector + Klemmleiste
- 2x USB Host Schnittstelle
- Beliebige Anzahl an Modulen anreihbar
- Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
- Versorgungsspannung: 12–24V DC
- Hutschienengehäuse: 6TE
- Modulares System, beliebig erweiterbar
- Weitere Hutschienen-Module erhältlich
 - z.B. Motorcontroller (9TE), DIN-Rail ADDA 6I40 (6TE), DIN-Rail Relais 6I6S (6TE), DIN-Rail CPU 10 (1TE), DIN-Rail CPU 60 (6TE)
- Alle Module können über RS485 miteinander kommunizieren
- einfache Verbindung der einzelnen Module über passende Busverbinder möglich
- Linux Betriebssystem, BSP mit Toolchain + Quellen werden frei mitgeliefert

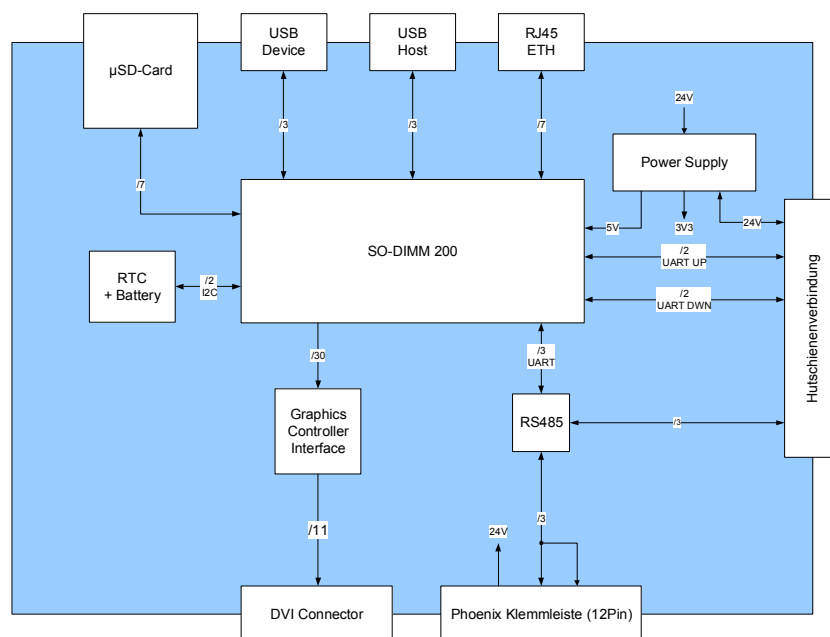


Abbildung 1: Blockschaltbild

Anschlussbelegung:

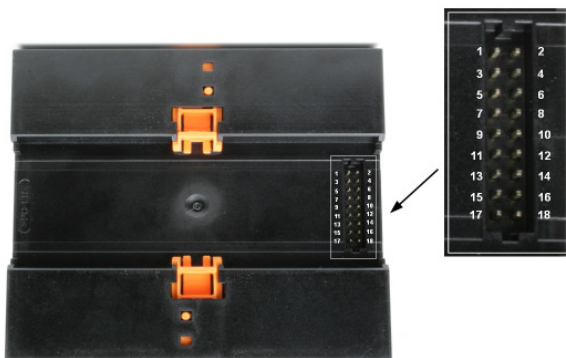


Abbildung 2: Pinbelegung BUS Connector

BUS-Connector:

1 – NC	2 – NC
3 – +24V	4 – +24V
5 – GND	6 – GND
7 – RS485 A Host	8 – RS485 B Host
9 – GND	10 – GND
11 – NC	12 – NC
13 – GND	14 – GND
15 – NC	16 – NC
17 – NC	18 – NC

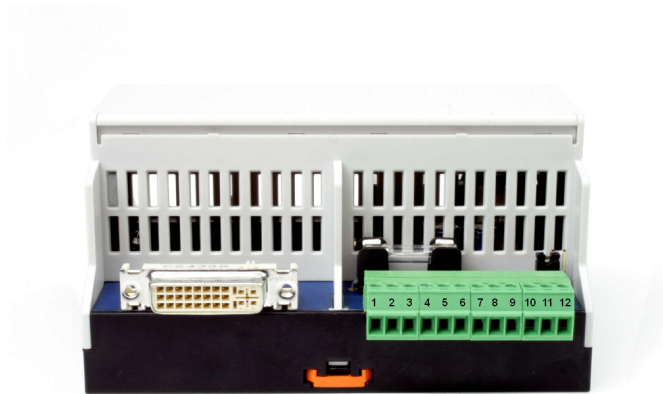


Abbildung 3: Pinbelegung Schraubklemmleiste

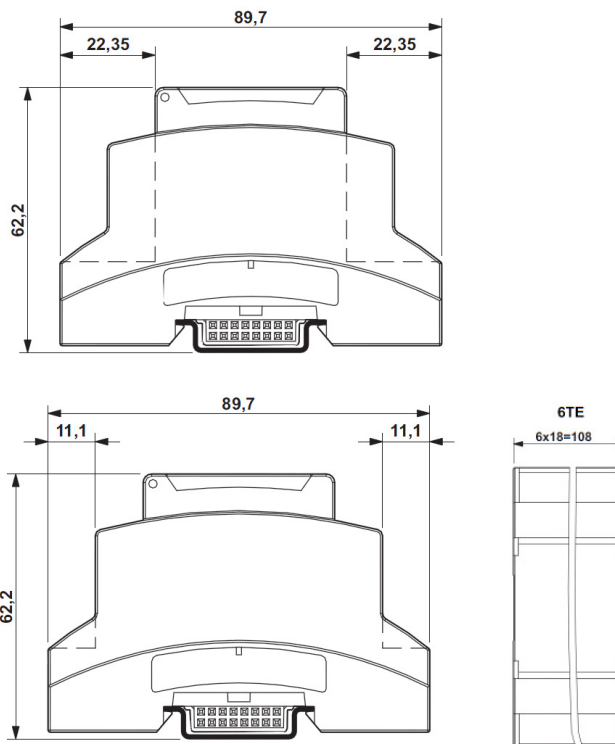
Schraubklemmleiste:

1 – +24V	7 – RS485-B_OUT
2 – +24V	8 – RS485-A_OUT
3 – +24V	9 – GND
4 – GND	10 – RS485-B_IN
5 – GND	11 – RS485-A_IN
6 – GND	12 – GND

Pinliste i.MX 536 SODIMM:

TBD

Maßzeichnung:



Kontakt

In-Circuit GmbH
 Königsbrücker Str. 69
 D-01099 Dresden
www.in-circuit.de
info@in-circuit.de

Bestellinformationen			
Beschreibung	Artikelnummer	Verpackung	Mindestbestellmenge
DIN-Rail CPU 61 - i.MX 536 CPU Modul, 6TE	901.033	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail CPU 10 - SAM9G45 CPU Modul, 1TE	901.212	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail CPU 60 - i.MX 536 CPU Modul, 6TE	901.249B	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail ADDA 6160 - 6x ADC Input, 4x DAC Output 0-10V, 6TE	901.218	ESD-Tüte, Luftpolster	1
DIN-Rail Relais 616S - 6x Relais Schaltausgang, 4x Digitaleingang, 6TE	901.214	ESD-Tüte, Luftpolster	1
Busverbinder 1TE 2Slot - zur Verbindung von 1TE Modulen	303.061	ESD-Tüte, Luftpolster	1
Busverbinder 6TE 2Slot - zur Verbindung von 6TE Modulen	303.062	ESD-Tüte, Luftpolster	1
Micro SD-Karte 1GB - passende µSD-Karte für CPU Module	104.042	ESD-Tüte, Luftpolster	1

Änderungsliste

Version	Datum	Änderungsgrund	Bearbeiter
A	23.08.2013	Erstausgabe	Träger